

エッチング工程を必要としない 環境配慮型プリント配線基板製造工法の開発

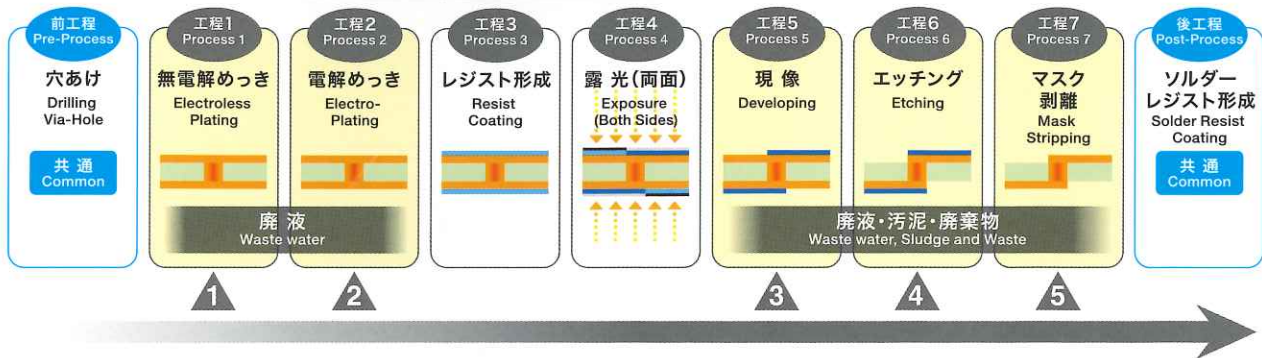
Development of Environmentally-Friendly PWB Manufacturing Method without Chemical-Etching

環境配慮型プリント配線基板 Environmentally-Friendly Printed Wiring Boards

エッチングからスクリーン印刷へ 環境にやさしいアディティブ法でPWBを製造

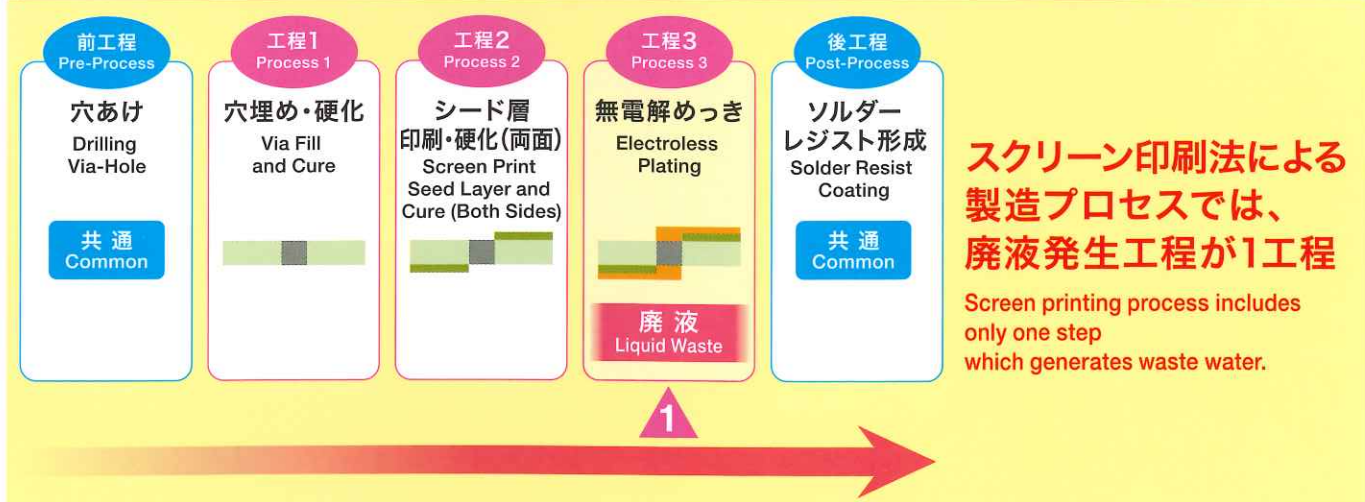
Shift from etching to screen printing PWB manufactured only by environmentally-friendly additive process

現状のパターン形成プロセス Conventional Process for Forming Circuit Pattern



現状の製造プロセスでは、廃液発生工程が5工程
Conventional process includes 5 steps which generate waste water.

スクリーン印刷法および無電解めっきによるパターン形成プロセス Screen Printing and Electroless Plating Process for Forming Circuit Pattern



本研究は、中小企業庁平成26年度戦略的基盤技術高度化支援事業で採択された「エッチング工程を必要としない環境配慮型プリント配線基板製造工法の開発」プロジェクトの助成で実施しました。
This project was conducted by a subsidy for "Development of Environmentally-Friendly PWB Publication Method without Chemical-Etching" which was adopted by The Small and Medium Enterprise Agency Strategic Foundational Technology Improvement Support Operation 2014.

- ふくおかIST、福岡大学半導体実装研究所
- FUKUOKA IST, Center of System Integration Platform Organization Standards, Fukuoka University
- アサダメッシュ株式会社
- 奥野製薬工業(株)総合技術研究所
- ASADA MESH CO., LTD.
- OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.
- 互応化学工業(株)電子化学品事業部
- タツタ電線(株)システム・エレクトロニクス事業本部
- GOO CHEMICAL CO., LTD.
- TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.